



# 封装电磁仿真解决方案

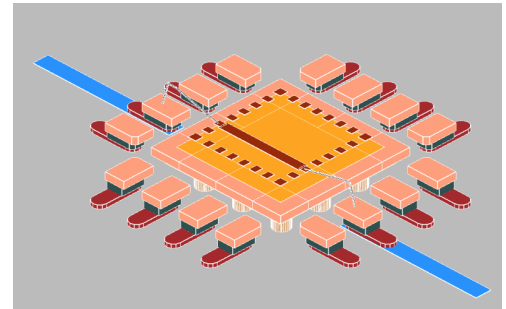


## 法动EDA系列解决方案

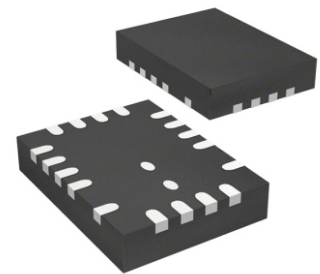
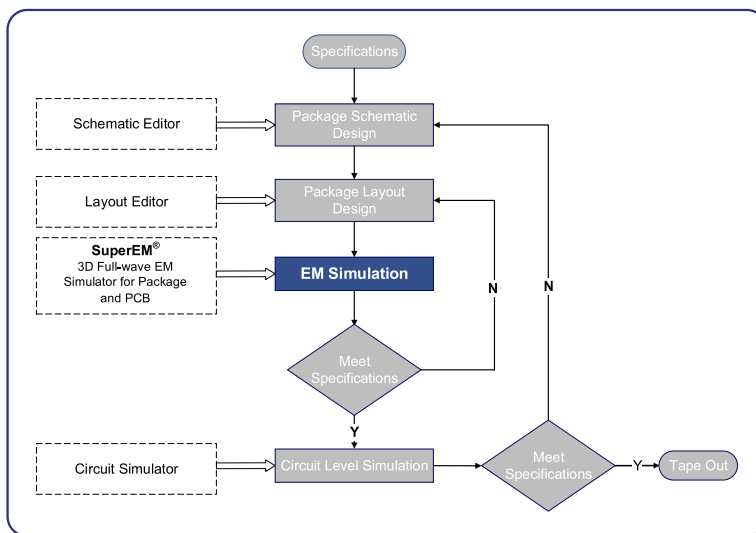
# Faraday Dynamics

### 介绍

法动科技针对封装和PCB级的电磁仿真软件SuperEM<sup>®</sup>采用领先的三维全波电磁仿真技术，用于分析高速PCB和IC封装的电磁场效应，并与业界领先的模拟芯片设计环境进行无缝整合，为广大的设计人员提供高精度电磁分析服务，以黄金标准精度应对更复杂的电磁（EM）挑战，本案例将展示QFN（方形扁平无引脚封装）的S参数仿真流程以供参考。

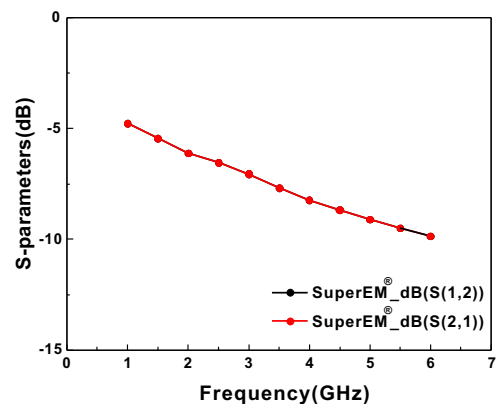
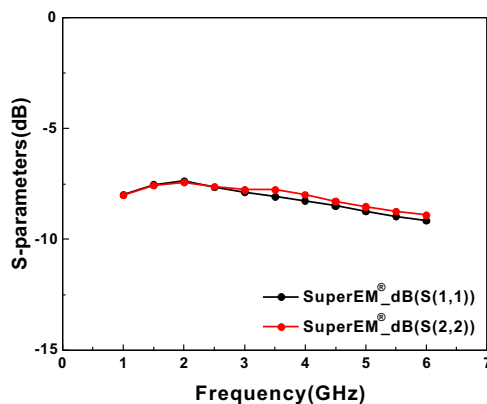


### 设计流程



QFN封装具有良好电性能和热性能，体积小，重量轻，成本低廉等特点，其中芯片和封装部分一般采用键合线（Bonding Wire）相连。

### 仿真结果



本案例介绍了采用法动科技的SuperEM<sup>®</sup>三维全波电磁软件对QFN模型的仿真。SuperEM<sup>®</sup>易于上手的界面实现了工艺配置、模型导入、端口创建等功能，快速完成模型的建模和仿真，可满足用户对封装进行快速建模仿真的应用场景需求。

地址：杭州市钱塘区经济开发区白杨街道6号大街452号  
电话：0571-88979233  
邮编：310018  
网址：www.faradynamics.com

